

本期封面



2000年8期

栏目:

DOI:

论文题目: Cu / Al₂O₃扩散焊接头界面晶体位向关系对断裂能量的影响

作者姓名: 刘伟平 Elssn., G

工作单位: 大连铁道学院材料科学与工程系, 大连 116028

通信作者: 刘伟平

通信作者Email: lwp@dlrin.edu.cn

文章摘要: 以单晶 α -Al₂O₃陶瓷(蓝宝石)和单晶Cu为母材, 采用真空扩散焊接获得具有两种不同的界面晶体位向关系的Cu / Al₂O₃扩散焊接头以及带Nb膜中间层的Cu / Nb / Al₂O₃扩散焊接头, 研究了界面晶体位向关系对接头断裂能量的影响, 响接头的断裂能量, 界面位向关系为(100) [011] cu || (0001) [1120] Al₂O₃的Cu / Al₂O₃接头断裂能量值最代.

关键词: 陶瓷 / 金属焊接 界面位向关系

分类号: TQ174.1 TG407

关闭